

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

中芯截至二零零八年六月三十日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零八年六月三十日止三個月的綜合經營業績。
- 非記憶體產品的銷售額與二零零八年第一季相比上升3.8%至 330,700,000 元，與二零零七年第二季相比上升 24%。然而總銷售額與二零零八年第一季相比下降 5.4%至 342,900,000 元，與二零零七年第二季相比下降 8.5%是由於執行二零零八年第一季的退出標準型記憶體產品市場的決定而使記憶體產品出貨量減少所致。記憶體產品占總銷售額的百分比由二零零八年第一季的 12.1%下降至 3.6%。來自于 0.13 微米全流程和 90 納米技術的邏輯產品的銷售額錄得季度升幅 14.5%。二零零八年第二季的毛利率為 6.1%，相較於二零零八年第一季的負 9.0%。簡化平均售價與二零零八年第一季的 798 元相比上升 6.9%至 853 元。二零零八年第二季公司錄得淨虧損 45,600,000 元，由於北京廠仍處於記憶體產品產能向邏輯體產品轉換的階段。每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 0.1227 元。
- 以下為本公司於二零零八年七月二十八日就截至二零零八年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零零八年七月二十八日作出本公佈。

以下為本公司於二零零八年七月二十八日就截至二零零八年六月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零零八年七月二十八日—國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零八年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零零八年第二季概要

- 非記憶體產品的銷售額與二零零八年第一季相比上升3.8%至 330,700,000 元，與二零零七年第二季相比上升 24%。
- 然而總銷售額與二零零八年第一季相比下降 5.4%至 342,900,000 元，與二零零七年第二季相比下降 8.5%是由於執行二零零八年第一季的退出標準型記憶體產品市場的決定而使記憶體產品出貨量減少所致。
- 記憶體產品占總銷售額的百分比由二零零八年第一季的 12.1%下降至 3.6%。
- 來自于 0.13 微米全流程和 90 納米技術的邏輯產品的銷售額錄得季度升幅 14.5%。
- 二零零八年第二季的毛利率為 6.1%，相較於二零零八年第一季的負 9.0%。
- 簡化平均售價⁽¹⁾與二零零八年第一季的 798 元相比上升 6.9%至 853 元。
- 二零零八年第二季公司錄得淨虧損 45,600,000 元，由於北京廠仍處於記憶體產品產能向邏輯體產品轉換的階段。
- 每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 0.1227 元。

附注：

- (1) 總銷售收入除以總晶圓輸出量

二零零八年第一季業績修正

於二零零八年第一季度，本公司和我們的客戶達成協定退出標準型記憶體商品業務。本公司根據 SFAS 第 144 條的規定認為此協定表明北京廠的長期資產有減值的迹象。本公司目前已經完成了對北京廠的長期資產的減值分析，確認減值損失為 105,800,000 元。二零零八年第一季度的財務資料已在本次發佈的第 22 頁重申。

關於本季營運成果，中芯國際總首席執行官張汝京博士透過電話會議向分析師們表示：“就整體而言，如預估，2008 年第二季的銷售額雖略微下降至 3.429 億元，但由於我們在邏輯晶片服務的增長，相較於上季度，我們的虧損明顯的大幅縮減至 4.56 千萬元。第二季度的虧損主要系來自於將北京廠 DRAM 的產能轉換為邏輯產能的計劃持續在進行當中。

DRAM 的產能轉換為邏輯的計劃已有些成功的果效。不少新的邏輯晶片投片已達到高量率標準並在等待客戶認證，其中一些已經進入量產。邏輯晶片在第二季的總出貨量增加了 7.8%；並預算在 2008 年與 2007 年相比將增加達 30%。我們策略的主軸依然是持續增加邏輯的產能，這將使我們的服務更符合市場需求。

在第二季，雖然美國整體的經濟處於很嚴峻的情況，但就客戶方面，我們依然見證了強勁的需求。8 英寸產能需求量連續兩季強勁。預測 2008 年下半年客戶的需求將持續增長，尤其是在通訊類以及在消費者產品的應用，如數碼電視、行動電視、和無線網絡晶片，這兩大類別佔我們絕大部分的業務。就地區方面，北美地區銷售穩固，而在亞洲地區，包括中國大陸和臺灣，呈現了最為顯著的成長。

我們致力於持續發展先進技術制程，而越來越多的客戶亦是成功的向更先進的制程邁進。估計第三季度 0.13um 及 90nm 的邏輯出貨量可增加約 10%。我們在先進製程的部份，已經開始研發自有 65 納米的元庫和單元，而與 IBM 在 45 納米的合作上亦是順利的如期進行當中。

我們很高興看到中國客戶強勁的發展。當我們持續替一些客戶在 90 納米製程提供服務時，我們也開始和他們在 65 納米的制程有了進展。其中一家客戶發表了他們，由中芯國際所製造，新的 RFID 產品，並在這個月正式獲得了 EPC Global 的認證。此項產品是首次由中國製造的 RFID 產品成功通過此國際認證。在未來，我們將會持續增強我們在中國國內的優勢，並與國內的晶片設計公司攜手合作。

在太陽能方面，我們很滿意它帶來的業務和利潤，並即將行動的擴展計劃。我們將會擴展太陽能的產能到現有的五到六倍，計劃將於 2009 年前半年完成。

當我們持續執行既有之發展計劃，在未來幾年，我們堅信將能為全球的客戶創造更大的價值，並進一步提升投資人的權益。

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零八年七月二十九日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342 (密碼：SMIC) 或香港 852-3002-1672 (密碼：SMIC)。

二零零八年第二季業績公佈網上直播可於 www.smics.com 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

關於中芯

中芯國際（“SMIC”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港恒生股票代碼：0981.HK）總部位於中國上海，是世界領先的集成電路晶片代工公司之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 65 納米及更先進的晶片製造服務。公司在上海的旗艦廠擁有一座 12 吋晶片廠及三座 8 吋晶片廠。北京旗艦廠建有兩座 12 吋晶片廠，在天津建有一座 8 吋晶片廠，在深圳的晶片廠正在建造中，在成都還建有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立銷售辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際受委託經營管理成都成芯半導體製造有限公司的一座 8 吋晶片廠，以及武漢新芯集成電路製造有限公司的一座 12 吋晶片廠。

本公司已經將截止二零零七年十二月三十一日的年報以 20-F 表格形式呈交予美國證券交易委員會。本公司網站 <http://www.smics.com> 提供此年報。此外，所有中芯國際美國預托證券持有人有權要求免費獲得本公司完整的經審計的財務報告的硬拷貝。

詳細資訊請參考中芯國際網站 <http://www.smics.com>

安全港聲明

（根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案）

本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括我們對於二零零八年第三季銷售額的預期，我們預期經營表現將改善一旦加速生產邏輯產品，我們預期邏輯晶圓在二零零八年出貨量將增加，我們對於在二零零八年餘下的時間持續強勁的市場需求的預期，進一步與內地無廠房設計公司的合作的預期，65 納米技術產品開始商業生產時間的預期，中芯於二零零八年加強和改善盈利能力的預期，以及在隨後“資本概要”和“二零零八年第三季”指引中的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、

「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零八年六月二十七日以 20-F 表格形式呈交予證交會的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則為本新聞發佈日期）的情況而表述。除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

重大訴訟

台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日，台積電入稟加州阿拉米達郡最高法院，就指稱本公司違反和解協議、違反承兌票據及不當使用商業機密而對本公司及若干附屬公司（中芯上海、中芯北京及中芯美國）提出訴訟。台積電訴求（其中包括）損害賠償、禁制令、律師費及提早支付和解協議項下尚未支付之金額。

在當前之訴訟中，台積電指稱本公司將台積電之商業機密運用於製造本公司0.13微米或更小之工藝產品。台積電進一步稱，由於本公司違約，有關台積電之專利牌照已予終止而有關本公司較大工藝產品之不起訴契約已失效。

本公司強烈否認所有不當使用之指控。法院並無證據證明台積電之索償屬有效，亦未確定審判日期。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除提出強烈抗辯台積電在美國訴訟提出的指控外，本公司已於二零零六年九月十二日反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反默示的真實公平交易的契諾，要求台積電作出損害賠償。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司及本公司的全資

子公司中芯上海及中芯北京共同提起的針對台積電違反誠實信用原則、商業詆毀的不公平競爭行為的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司尋求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、台積電公開向本公司道歉和賠償（包括台積電因其侵權行為所獲得的利潤）。

台積電於二零零七年一月向美國加州法院動議尋求禁制中國訴訟。於二零零七年二月，台積電向北京市高級人民法院提出司法管轄權的異議，質疑北京市高級人民法院對中國訴訟的司法管轄權限。

二零零七年三月，加州法院駁回台積電有關禁制中國訴訟的動議，台積電就加州法院的判決上訴。於二零零八年三月二十六日，上訴法院以書面形式否認台積電的上訴。

於二零零七年七月，北京市高級人民法院駁回台積電對中國訴訟的司法管轄權的異議並認為北京市高級人民法院擁有適當的司法管轄權審理該訴訟。台積電就北京市高級人民法院的判決，向中華人民共和國最高人民法院提出上訴。二零零八年一月七日，最高法院審理了台積電的訴訟，並於二零零八年六月十三日駁回台積電的上訴，確立了北京市高級人民法院對於本案的管轄權。

二零零七年八月十四日，本公司修訂對台積電提出的反訴，尋求（其中包括）台積電違約及違反專利許可協議的賠償。台積電隨後否認本公司關於修正反訴的指稱，並追加指稱本公司於北京市高級人民法院起訴台積電乃違反和解協定，。本公司已否認台積電此項追加指稱。

於二零零七年八月十五日至十七日，美國加州法院就台積電申請臨時禁制令欲禁止本公司製造或分銷特定的0.13微米或以下的邏輯技術產品作出聆訊。法院在二零零七年九月七日作出裁定。該裁定拒絕台積電提出的臨時禁制令申請，因而本公司的業務發展和銷售得以不受影響。但該裁定要求本公司若計劃在某些情況下披露其邏輯技術予非中芯國際的機構時，必須給予台積電十天的事先通知以讓台積電可就該披露提出反對。

於二零零八年三月十一日，台積電呈交一份於加州法院附加命令的申請。藉該申請，台積電尋求取得與本公司就和解協議而發出的承兌票據餘下結餘等值金額的命令。。本公司對該項申請表示反對。聆訊已於二零零八年四月三日召開。法院並於二零零八年六月二十四日駁回台積電該項申請。

二零零八年五月，台積電就本公司所提的多項反訴事由向加州法院請求進行簡易判決。本公司已反對該項請求，法院將於二零零八年七月二十五日開庭審理。

加州法院於二零零八年六月二十三日就本公司向加州法院另行提出台積電非法獲取本公司營業秘密藉以強化其對本公司競爭地位之反訴，並尋求相關的損害賠償等作出聆訊。

根據美國財務會計準則第 144 號，本公司須決定該未決訴訟是否構成需要進一步分析專利許可組合是否已受損害之事件。我們相信，該法律訴訟現處於初步階段，我們仍在評估訴訟是

否屬於該類事件。本公司預期將獲得進一步資料以協助我們做出決定。根據美國財務會計準則第 144 號進行之任何損害分析結果可能對本公司財政狀況及經營業績產生重大影響。由於訴訟仍處於初步階段，本公司未能評估頒佈不利判決的可能性或評估潛在虧損的金額或範圍。

投資者聯絡資料：

Theresa Teng

電話：+86-21-5080-2000，內線： 16278

theresa_teng@smics.com

En-Ling Feng

電話：+86-21-5080-2000，內線： 16275

Enling_Feng@smics.com

Anne Wong Chen

電話：+86-21-5080-2000，內線： 12804

Anne_Wong_Chen@smics.com

二零零八年第二季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度 ⁽³⁾	季度比較	二零零七年 第二季度	年度比較
銷售收入	342,919	362,369	-5.4%	374,829	-8.5%
銷售成本	322,077	394,940	-18.4%	336,339	-4.2%
毛利	20,842	(32,571)	-	38,490	-45.9%
經營開支	60,750	170,151	-64.3%	47,113	28.9%
經營虧損	(39,908)	(202,722)	-80.3%	(8,623)	362.8%
其他收入（支出），淨額	(5,193)	(3,596)	44.4%	6,085	-
所得稅利益（支出）	(2,046)	(19,142)	-89.3%	1,621	-
稅後淨虧損	(47,147)	(225,460)	-79.1%	(917)	5041.4%
少數股權	1,603	846	89.5%	(137)	-
應占聯營公司虧損	(85)	(241)	-64.7%	(1,001)	-91.5%
普通股持有人應占虧損	(45,629)	(224,855)	-79.7%	(2,054)	2121.5%
毛利率	6.1%	-9.0%		10.3%	
經營利潤率	-11.6%	-55.9%		-2.3%	
每股普通股股份淨收入（虧損）－基本 ⁽¹⁾	(0.0025)	(0.0121)		(0.0001)	
每股美國預托股份淨收入（虧損）－基本	(0.1227)	(0.6051)		(0.0056)	
每股普通股股份淨收入（虧損）－攤薄 ⁽¹⁾	(0.0025)	(0.0121)		(0.0001)	
每股美國預托股份淨收入（虧損）－攤薄	(0.1227)	(0.6051)		(0.0056)	
付運晶圓（8吋等值） ⁽²⁾	402,114	454,259	-11.5%	443,445	-9.3%
產能使用率	92.2%	92.1%		88.9%	

附注：

(1) 基於二零零八年第二季加權平均普通股 18,589,000,000 股（基本）及 18,589,000,000 股（攤薄），二零零八年第一季度 18,579,000,000 股（基本）及 18,579,000,000 股（攤薄），二零零七年第二季度 18,476,000,000 股（基本）及 18,476,000,000 股（攤薄）。

(2) 包括銅接連件

(3) 重申

- 非記憶體產品的銷售額與二零零八年第一季相比上升3.8%至 330,700,000 元,與二零零七年第二季相比上升 24%。
- 然而二零零八年第二季的總銷售額與二零零八年第一季的362,400,000元相比下降5.4%至 342,900,000 元,與二零零七年第二季的 374,800,000 元相比下降 8.5%是由於記憶體產品出貨量減少。
- 二零零八年第二季的銷售成本與二零零八年第一季的 394,900,000 元相比,下降 18.4%至 322,100,000 元,是由於記憶體產品出貨量減少。
- 二零零八年第二季的毛利與二零零八年第一季的毛利相比下,從負 32,600,000 元增加到盈利 20,800,000 元,與二零零七年第二季的毛利 38,500,000 元相比下,則下降 45.9%。
- 二零零八年第二季的毛利率由二零零八年第一季的負 9.0%增加至 6.1%,主要是由於公司逐漸的退出標準型記憶體產品市場所致。
- 將二零零八年第一季資產的減值損失 105,800,000 元排除在外,二零零八年第二季的總經營開支由二零零八年第一季的 64,400,000 元下降 5.6%至 60,800,000 元,主要由於一般行政費用的減少加上研發費用增加所致。
- 二零零八年第二季的研發費用由二零零八年第一季的 34,200,000 元上升 10.1%至 37,700,000 元主要由於上海新的 12 英寸廠的啓動費用增加所致。
- 二零零八年第二季的一般行政費用由二零零八年第一季的 18,600,000 元下降至 13,300,000 元,主要由於二零零八年第二季獲得的匯兌收益為 5,000,000 元,而二零零八年第一季為匯兌損失 1,700,000 元。
- 二零零八年第二季的銷售費用由二零零八年第一季的 4,900,000 元下降 10.8%至 4,400,000 元,主要是由於與銷售行為相關的成本耗費下降所致。

收入分析：

銷售分析			
以應用分類	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	二零零七年 第二季度
電腦	7.9%	12.8%	25.2%
通訊	51.1%	54.3%	40.7%
消費	32.4%	25.9%	24.3%
其他	8.6%	7.0%	9.8%
以服務分類	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	二零零七年 第二季度
邏輯 ⁽³⁾	85.7%	78.4%	61.8%
記憶	3.6%	12.1%	28.9%
管理服務	2.6%	2.5%	3.2%
光罩製造，探測及其它	8.1%	7.0%	6.1%
以客戶類別分類	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	二零零七年 第二季度
非廠房半導體公司	54.6%	54.4%	43.8%
集成裝置製造商	25.7%	31.6%	42.3%
系統公司及其它	19.7%	14.0%	13.9%
以地區分類	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	二零零七年 第二季度
北美洲	55.1%	53.6%	39.6%
亞太區（不包括日本）	34.7%	29.9%	29.1%
日本	3.6%	3.9%	8.9%
歐洲	6.6%	12.6%	22.4%
晶圓收入分析			
各技術占晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、 記憶及銅接連件）	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	二零零七年 第二季度
0.09 微米	18.4%	19.8%	22.0%
0.13 微米	22.9%	25.0%	33.0%
0.15 微米	2.1%	4.2%	1.2%
0.18 微米	37.7%	32.1%	30.8%
0.25 微米	0.6%	0.5%	0.7%
0.35 微米	18.3%	18.4%	12.3%
各邏輯技術占邏輯晶圓銷售額百分比 ⁽¹⁾	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	二零零七年 第二季度
0.09 微米	16.4%	14.7%	15.3%
0.13 微米 ⁽²⁾	21.8%	20.3%	19.0%

0.15 微米	2.2%	5.0%	1.9%
0.18 微米	39.6%	37.8%	43.6%
0.25 微米	0.6%	0.5%	0.9%
0.35 微米	19.4%	21.7%	19.3%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 代表來自于全流程製造晶圓的銷售收入
- (3) 包括 0.13 微米銅接連件

產能：

廠／（晶圓尺寸）	二零零八年 第二季度*	二零零八年 第一季度*
上海廠（8 吋）	86,000	88,000
北京廠（12 吋）	40,500	54,000
天津廠（8 吋）	28,000	25,396
每月晶圓裝配總產能	154,500	167,396

附注：

* 期終每月晶圓計 8 吋等值

- 截至二零零八年第二季度末，每月產能下降至 154,500 片 8 吋等值晶圓是由於記憶體產品轉換為邏輯產品的產品組合的更換。

付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	二零零七年 第二季度
付運晶圓（包括銅接連件）	402,114	454,259	443,445
使用率(1)	92.2%	92.1%	88.9%

附注：

- (1) 產能使用率按輸出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零零八年第二季晶圓付運數量較二零零八年第一季的 454,259 片 8 吋等值晶圓下降 11.5% 至 402,114 片 8 吋等值晶圓，較二零零七年第二季度的 443,445 片 8 吋等值晶圓錄得年度下降 9.3%，主要由於記憶體產品的出貨量下降。
- 然而，二零零八年第二季邏輯產品的出貨量增加至 360,623 片 8 吋等值晶圓，較二零零八年第一季與二零零七年第二季度，分別錄得季度升幅 7.8% 及年度升幅 41.5%。

詳細財務分析

毛利分析：

以千美元計	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	季度比較	二零零七年 第二季度	年度比較
銷售成本	322,077	394,940	-18.4%	336,339	-4.2%
折舊	153,783	159,715	-3.7%	159,154	-3.4%
其他製造成本	160,938	227,731	-29.3%	168,408	-4.4%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	0.0%	5,886	0.0%
股權報酬	1,470	1,608	-8.6%	2,891	-49.2%
毛利	20,842	(32,571)	-	38,490	-45.9%
毛利率	6.1%	-9.0%		10.3%	

- 二零零八年第二季的銷售成本與二零零八年第一季的 394,900,000 元相比，下降 18.4% 至 322,100,000 元，是由於記憶體產品出貨量減少。
- 二零零八年第二季的毛利與二零零八年第一季的毛利相比下，從負 32,600,000 元增加到盈利 20,800,000 元，與二零零七年第二季的毛利 38,500,000 元相比下，則下降 45.9%。
- 二零零八年第二季的毛利率由二零零八年第一季的負 9.0% 增加至 6.1%，主要是由於公司逐漸的退出標準型記憶體產品的市場所致。

經營開支分析

以千美元計	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度 ⁽¹⁾	季度比較	二零零七年 第二季度	年度比較
總經營開支	60,750	170,150	-64.3%	47,113	28.9%
研究及開發	37,684	34,233	10.1%	23,194	62.5%
一般及行政	13,328	18,606	-28.4%	14,746	-9.6%
銷售及市場推廣	4,356	4,883	-10.8%	4,234	2.9%
無形資產攤銷	6,898	6,784	1.7%	6,213	11.0%
資產處置損失(收入)	(1,517)	(130)	1066.9%	(1,274)	19.1%
長期資產的減值損失	-	105,774	-	-	-

附注：

(1) 重申

- 將二零零八年第一季長期資產的減值損失排除在外，二零零八年第二季的總經營開支由二零零八年第一季的 64,400,000 元下降 5.6% 至 60,800,000 元，主要由於一般行政費用的減少加上研發費用增加所致。
- 二零零八年第二季的研發費用由二零零八年第一季的 34,200,000 元上升 10.1% 至 37,700,000 元主要由於上海新的 12 英寸廠的啓動費用增加所致。
- 二零零八年第二季的一般行政費用由二零零八年第一季的 18,600,000 元下降至 13,300,000 元，主要由於二零零八年第二季獲得的匯兌收益為 5,000,000 元，而二零零八年第一季為匯兌損失 1,700,000 元。
- 二零零八年第二季的銷售費用由二零零八年第一季的 4,900,000 元下降 10.8% 至 4,400,000 元，主要由於與銷售行為相關的成本耗用下降所致。
- 鑒於北京廠決定退出標準型記憶體產品市場，二零零八年第一季度記錄了資產減值損失 105,800,000 元。

其他收入（支出）：

以千美元計	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度	季度比較	二零零七年 第二季度	年度比較
其他收入(支出)	(5,193)	(3,596)	44.4%	6,085	-
利息收入	4,059	3,758	8.0%	2,679	51.5%
利息支出	(15,279)	(17,267)	-11.5%	3,343	-
其他，淨額	6,027	9,913	-39.2%	63	9466.7%

- 二零零八年第二季的其他非經營性損失為 5,200,000 元，二零零八年第一季為 3,600,000 元，主要是由於與非經營性活動相關的匯兌收益減少及利息費用減少所致。

流動資金：

以千美元計	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度
現金及現金等價物	480,265	506,320
限制用途現金	91,130	
短期投資	32,326	29,474
應收賬款	262,418	283,932
存貨	252,394	216,159
其他	64,767	59,036
流動資產總計	1,183,300	1,094,921
應付賬款	345,801	290,677

短期借款	242,908	137,470
長期借款的即期部份	341,630	341,620
其他	159,958	181,054
流動負債總計	1,090,297	950,821
現金比率	0.5x	0.5x
速動比率	0.8x	0.9x
流動比率	1.1x	1.2x

資本結構：

以千美元計	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度
現金及現金等價物	480,265	506,320
限制用途現金	91,130	
短期投資	32,326	29,474
長期票據即期部分	29,242	29,493
長期票據	37,441	51,495
短期借款	242,908	137,470
長期借款的即期部份	341,630	341,620
長期借款	695,292	639,058
總借款	1,279,830	1,118,148
股東權益	2,749,470	2,791,633
總借款對權益比率	46.5%	40.1%

現金流量概要

以千美元計	二零零八年 第二季度	二零零八年 第一季度
來自于經營活動的現金淨額	147,211	136,231
來自于投資活動的現金淨額	(320,120)	(153,727)
來自于融資活動的現金淨額	146,927	54,594
現金變動淨額	(26,055)	37,036

資本開支概要

- 二零零八年第二季資本開支為 231,000,000 元。
- 計劃下的二零零八年資本開支總額將約為 700,000,000 元，並且將根據市場狀況作調整。

二零零八年第三季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 銷售收入預期增加 5%–8%
- 經營開支相對銷售的百分比預期為 20%左右。
- 資本開支預期約介於 230,000,000 元至 280,000,000 元之間。
- 折舊及攤銷費用預期約介於 190,000,000 元至 210,000,000 元之間。

近期公佈

- 2008 年 6 月 2 日舉行之股東周年常會投票表決結果（二零零八年六月二日）
- 董事變更（二零零八年六月二日）
- 關於中國四川省地震影響（二零零八年五月十四日）
- 暫停辦理股份過戶登記（二零零八年五月七日）
- 中芯截至二零零八年三月三十一日止三個月業績公佈（二零零八年四月二十九日）
- 股東周年大會通告，重選董事，建議授出發行及購回股份之一般授權及建議修訂組織章程細則（二零零八年四月二十九日）
- 二零零七年年業績公佈（二零零八年四月二十七日）
- 中芯國際和晶晨半導體成功量產 90 納米數碼相框晶片（二零零八年四月二十四日）
- 中芯國際和香港應用科技研究院合作，開發出全球首款符合 WLP/WiNET 網路標準和中國閃聯 IGRS 網路標準的雙模 UWB MAC ASIC 晶片（二零零八年四月二十一日）
- 第三代全國標數位電視通道解調晶片 LGS-8G52 面市—中芯國際助力凌訊科技推動數位高清“芯”時代（二零零八年四月十八日）
- 股票價格不尋常波動（二零零八年四月十五日）
- 合資格會計師豁免延期（二零零八年四月七日）
- 中芯國際任命林夏如女士為首席策略顧問（二零零八年四月二日）

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp

合并資產負債表
(美元)

截至以下日期止

	二零零八年 六月三十日 (未經審核)	二零零八年 三月三十一日 (未經審核)
資產		
流動資產：		
現金及現金等價物	480,265,390	506,320,313
限定用途的現金	91,129,665	-
短期投資	32,325,653	29,473,900
應收賬款，已扣除撥備（二零零八年六月三十日為 4,491,881 元，二零零八年三月三十一日為 4,084,646 元）	262,418,476	283,931,518
存貨	252,393,858	216,159,019
預付款項及其它流動資產	43,757,844	38,642,090
廠房、機台及其它固定資產銷售應收款	19,503,560	17,355,300
待售資產	1,505,287	3,038,345
流動資產合計	1,183,299,733	1,094,920,485
土地使用權，淨額	56,973,227	57,242,556
廠房及設備，淨額	3,073,939,856	3,030,342,825
購入無形資產，淨額	219,542,603	226,440,883
遞延成本	58,864,395	64,750,835
股權投資	9,570,309	9,655,431
其他長期預付款	2,431,307	2,893,411
遞延稅資產	44,482,712	38,102,589
資產合計	4,649,104,142	4,524,349,015
負債及股東權益		
流動負債：		
應付帳款	345,801,391	290,676,671
預提費用及其它流動負債	130,233,266	151,044,251
短期借款	242,907,613	137,470,000
長期票據的即期部份	29,242,001	29,492,873
長期借款的即期部份	341,630,053	341,620,480
應付所得稅	482,264	516,451
流動負債合計	1,090,296,588	950,820,726
長期負債：		
長期票據	37,440,879	51,495,193
長期借款	695,291,528	639,058,040

與特許權協定相關的長期應付款	43,488,864	56,778,942
遞延稅負債	621,029	464,837
長期負債合計	776,842,300	747,797,012
負債合計	1,867,138,888	1,698,617,738
少數股權	32,495,675	34,098,639
股東權益：		
普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，截止二零零八年六月三十日已發行股份為 18,592,920,335 股，截止二零零八年三月三十一日已發行的股份為 18,583,994,474 股。	7,437,168	7,433,598
額外繳入股本	3,320,932,081	3,317,395,859
累計其他綜合虧損	(137,073)	(63,647)
累計虧絀	(578,762,598)	(533,133,172)
所有股東權益合計	2,749,469,578	2,791,632,638
總負債及股東權益合計	4,649,104,142	4,524,349,015

合并營運報表
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零八年 六月三十日 (未經審核)	二零零八年 三月三十一日 (未經審核)
銷售額	342,919,148	362,368,556
銷售成本	322,076,702	394,939,583
毛利	20,842,446	(32,571,027)
經營費用：		
研究和開發	37,684,073	34,232,685
一般及行政	13,328,153	18,605,813
銷售和市場推廣	4,356,161	4,883,475
購入無形資產攤銷	6,898,279	6,784,250
長期資產的減值損失	-	105,774,000
來自廠房設備和其他固定資產的銷售損失(所得)	(1,516,754)	(129,573)
經營費用總額	60,749,912	170,150,650
經營虧損	(39,907,466)	(202,721,677)
其他收入(支出)：		
利息收入	4,058,901	3,758,119
利息支出	(15,279,685)	(17,266,845)
匯兌收益(虧損)	2,478,287	10,317,302
其他收入(支出)，淨額	3,549,159	(404,404)
其他收入(支出)，淨額	(5,193,338)	(3,595,828)
所得稅、少數股權及股權投資虧損前淨虧損	(45,100,804)	(206,317,505)
所得稅費用	(2,046,464)	(19,141,832)
少數股權	1,602,964	845,769
股權投資虧損	(85,122)	(240,967)
淨虧損	(45,629,426)	(224,854,535)
每股股份淨虧損，基本	(0.0025)	(0.0121)
每股美國預托股份淨虧損，基本	(0.1227)	(0.6051)

每股股份淨虧損，攤薄	(0.0025)	(0.0121)
每股美國預托股份淨虧損，攤薄	(0.1227)	(0.6051)
用作計算基本每股普通股 虧損額的股份	18,589,202,067	18,579,292,515
用作計算攤薄每股普通股 虧損額的股份	18,589,202,067	18,579,292,515

合并现金流量表
(美元)

截至以下日期止三個月

二零零八年
六月三十日
(未經審核)

二零零八年
三月三十一日
(未經審核)

經營活動：

淨虧損	(45,629,426)	(224,854,535)
淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
少數股權	(1,602,964)	(845,769)
遞延稅	(6,223,931)	18,672,650
處置廠房及設備損失(收益)	(1,516,754)	(129,573)
折舊及攤銷	187,912,371	191,728,933
購入無形資產攤銷	6,898,279	6,784,250
股權報酬	3,293,295	3,596,628
長期票據非現金利息費用	1,839,073	2,073,335
股權投資虧損	85,122	240,967
長期資產的減值損失		105,774,000
營運資產及負債的變動：		
應收賬款，淨額	21,513,042	14,456,133
存貨	(36,234,839)	32,150,746
預付款及其它流動資產	(6,011,332)	(7,309,344)
應付賬款	33,225,078	(16,094,831)
預提費用及其它流動負債	(10,301,330)	10,623,203
應付所得稅	(34,187)	(636,179)
經營活動所得現金淨額	147,211,497	136,230,614

投資活動：

購入廠房及設備	(204,346,529)	(114,217,902)
處置廠房及設備所得款項	9,157	484,943
出售待售資產所得款項	642,452	690,161
購買所獲無形資產	(22,443,824)	(18,848,000)
購買短期投資	(94,846,471)	(41,975,501)
出售短期投資	91,994,718	20,139,472
轉換限定用途的現金	(91,129,665)	
投資活動所耗現金淨額	(320,120,162)	(153,726,827)

融資活動：

短期借款所得款項	208,437,613	72,050,000
長期借款所得款項	227,024,023	23,690,989
償還長期票據支付的款項	(15,000,000)	–
償還長期借款支付的款項	(170,780,962)	–
償還短期借款支付的款項	(103,000,000)	(41,580,000)
行使雇員購股權所得款項	246,496	433,289
融資活動所得（所耗）現金淨額	146,927,170	54,594,278
匯率變動的影響	(73,428)	(61,765)
現金及現金等價物增加淨額	(26,054,923)	37,036,300
現金及現金等價物－期間開始	506,320,313	469,284,013
現金及現金等價物－期間結束	480,265,390	506,320,313

	二零零八年 三月三十一日 (調整後)	二零零八年 三月三十一日 (調整前)
合併資產負債表		
廠房及設備，淨額	3,030,342,825	3,136,116,825
總資產	4,524,349,015	4,630,123,015
累計虧絀	(533,133,172)	(427,359,172)
股東權益合計	2,791,632,638	2,897,406,638
負債及股東權益合計	4,524,349,015	4,630,123,015

合併營運報表

長期資產減值損失	105,774,000	-
經營費用總額	170,150,650	64,376,650
經營虧損	(202,721,677)	(96,947,677)
所得稅、少數股權及股權投資虧損前淨虧損	(206,317,505)	(100,543,505)
淨虧損	(224,854,535)	(119,080,535)
每股股份淨虧損，基本	(0.0121)	(0.0064)
每股美國預托股份淨虧損，基本	(0.6051)	(0.3205)
每股股份淨虧損，攤薄	(0.0121)	(0.0064)
每股美國預托股份淨虧損，攤薄	(0.6051)	(0.3205)

合併現金流量表

淨虧損	(224,854,535)	(119,080,535)
長期資產減值損失	105,774,000	

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席兼獨立非執行董事王陽元先生、本公司總裁、首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事汪正綱先生、以及本公司獨立非執行董事徐大麟先生、川西剛先生、蕭崇河先生、陳立武先生及江上舟先生。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
首席執行官
張汝京

中國上海，二零零八年七月二十八日

* 僅供識別